

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

关于对外投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● **重要内容提示：**盛剑环境下属子公司盛剑半导体作为“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目”的实施主体，以人民币 3,328.00 万元竞得上海市嘉定区嘉定工业区（北区）JDSB0301、JDSB0302、JDSB0303 单元 64-03 地块的国有建设用地使用权，并于 2023 年 12 月 8 日签订《上海市国有建设用地使用权出让合同》。

● **相关风险提示：**本次盛剑半导体竞得土地使用权、签署《出让合同》后，还需办理出让土地使用权登记等相关工作，相关事项尚存在一定的不确定性。公司将密切关注对外投资事项后续进展情况，根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（本文简称“公司”、“盛剑环境”）分别于 2021 年 12 月 8 日、2021 年 12 月 24 日召开第二届董事会第九次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于签署项目投资协议及其补充协议并设立全资子公司的议案》。为实现战略布局以及半导体领域产业价值延伸，公司与上海嘉定工业区管理委员会（以下简称“嘉定工业区管委会”）于 2021 年 12 月签署《国产半导体制程附属设备及关键零部件项目投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”）及其补充协议，拟在上海市嘉定工业区投资建设“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目”（以下简称“项目”），项目预计总投资人民币 60,000.00 万元，拟分两期投资建设。

为保障本项目的实施，公司对外投资设立全资子公司上海盛剑半导体科技有限公司（本文简称“盛剑半导体”）作为项目实施主体，投资建设内容包括半导体制程附属设备生产线、关键零部件加工制造维修中心、先进半导体制程附属装备研发中心以及综合运营总部等。盛剑半导体将通过招拍挂方式取得嘉定工业区内相关土地使用权用于新工业厂房的投资建设。具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 9 日、2021 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-065）、《关于签署项目投资协议及其补充协议并设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-067）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-070）。

二、对外投资进展情况

自《投资协议书》及其补充协议签订以来，公司一直在积极推动该项目进展，在过渡期间，盛剑半导体已在江苏昆山租赁厂房，持续开展半导体附属设备及关键零部件的研发、生产业务。

2023 年 8 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司盛剑半导体通过增资扩股方式引入外部投资者上海榄余坤企业管理中心（有限合伙）（以下简称“榄余坤企管”）及盛剑半导体员工持股平台 A（拟设立）、盛剑半导体员工持股平台 B（拟设立）（后两者合称“盛剑半导体员工持股平台”，公司全资子公司上海盛剑芯科企业管理有限公司拟作为两家公司员工持股平台的普通合伙人及执行事务合伙人）。本次外部投资者榄余坤企管及盛剑半导体员工持股平台拟合计对盛剑半导体投资金额为 4,900 万元（对应新增注册资本 1,750 万元，剩余 3,150 万元计入盛剑半导体资本公积）。增资完成后，公司持有盛剑半导体的直接持股比例为 85.11%，并通过盛剑半导体员工持股平台控制盛剑半导体 9.96% 的股权，其余股权由本次引入的外部投资者持有。

具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 5 日、2023 年 9 月 9 日、2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-059）《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-063）。

2023年12月6日，盛剑半导体以人民币3,328.00万元竞得嘉定区嘉定工业区（北区）JDSB0301、JDSB0302、JDSB0303单元64-03地块（地块公告号：202313802）的国有建设用地使用权，并取得《成交确认书》。根据出让文件的规定，盛剑半导体与上海市嘉定区规划和自然资源局于2023年12月8日签订《上海市国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“本合同”、“《出让合同》”）。

三、《出让合同》主要条款

- 1、出让人：上海市嘉定区规划和自然资源局
- 2、受让人：上海盛剑半导体科技有限公司
- 3、出让宗地编号：202313580173489192
- 4、宗地总面积：27728.60平方米
- 5、出让宗地面积：27728.60平方米（嘉定区嘉定工业区（北区）JDSB0301、JDSB0302、JDSB0303单元64-03地块）
- 6、出让宗地位置：嘉定工业区
- 7、出让宗地用途：工业用地
- 8、出让时间：出让人同意在签订本合同之日起45个工作日内，即2024年2月9日之前，将出让宗地交付给受让人，出让人同意在交付土地时该宗地应达到净地。
- 9、土地使用权出让年限：20年
- 10、土地使用权出让价款：人民币3,328.00万元
- 11、土地使用权出让价款的支付：本合同项下宗地的定金为土地出让价款的20%，定金抵作土地出让价款。自本合同签订之日起的5个工作日内，受让人应当向地方国库支付保证合同切实履行的定金。本合同签订之日起30个工作日内，一次性付清土地出让价款余额。
- 12、本合同项下宗地出让方案业经上海市嘉定区人民政府批准，本合同自双方签订之日起生效。

四、本次取得土地使用权对公司的影响

根据公司与嘉定工业区管委会签署的《投资协议书》及其补充协议，本宗地将作为“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目”用地。本次购买土地使用权的资金来源为盛剑半导体自有资金或自筹资金，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、后续事项及风险提示

本次盛剑半导体竞得土地使用权、签署《出让合同》后，还需办理出让土地使用权登记等相关工作，相关事项尚存在一定的不确定性。公司将密切关注对外投资事项后续进展情况，根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2023年12月12日